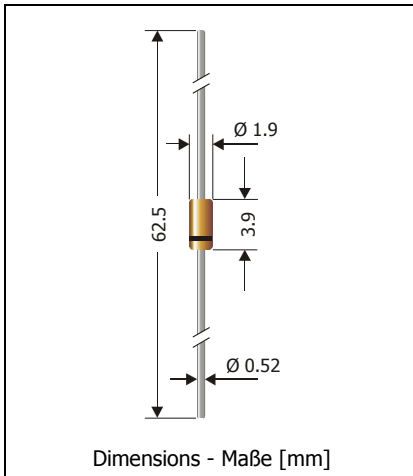


## SD103A ... SD103C

### Si-Schottky-Barrier Diodes Si-Schottky-Barrier Dioden

Version 2008-04-17



Nominal current Nennstrom	0.2 A
Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung	20...40 V
Glass case Glasgehäuse	DO-35 (SOD-27)
Weight approx. Gewicht ca.	0.13 g
Equivalent SMD-version Äquivalente SMD-Ausführung	LL103C...LL103A
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	



#### Maximum ratings (T<sub>A</sub> = 25°C)

#### Grenzwerte (T<sub>A</sub> = 25°C)

Type Typ	Repetitive peak reverse voltage Periodische Spitzensperrspannung V <sub>RRM</sub> [V]	Forward voltage Durchlass-Spannung V <sub>F</sub> [V]	
		I <sub>F</sub> = 20 mA	I <sub>F</sub> = 200 mA
SD103C	20	< 0.37	< 0.6
SD103B	30	< 0.37	< 0.6
SD103A	40	< 0.37	< 0.6

Power dissipation – Verlustleistung	T <sub>A</sub> = 25°C	P <sub>tot</sub>	400 mW <sup>1)</sup>
Peak forward surge current, 60 Hz half sine-wave Stoßstrom für eine 60 Hz Sinus-Halbwelle		I <sub>FSM</sub>	15 A
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T <sub>j</sub> T <sub>S</sub>	-50...+125°C -50...+175°C

#### Characteristics (T<sub>j</sub> = 25°C)

#### Kennwerte (T<sub>j</sub> = 25°C)

Leakage current Sperrstrom	SD103C V <sub>R</sub> = 10 V SD103B V <sub>R</sub> = 20 V SD103A V <sub>R</sub> = 30 V	I <sub>R</sub>	< 5 µA
Max. junction capacitance – Max. Sperrschichtkapazität	V <sub>R</sub> = 0 V, f = 1 MHz	C <sub>tot</sub>	typ. 50 pF
Reverse recovery time Sperrverzug	I <sub>F</sub> = 200 mA through/über I <sub>R</sub> = 200 mA to I <sub>R</sub> = 20 mA	t <sub>rr</sub>	typ. 10 ns
Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R <sub>thA</sub>	< 250 K/W <sup>1)</sup>

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

1 Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 5 mm from case  
Gültig, wenn die Anschlussdrähte in 5 mm Abstand vom Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden